PLATING DEVICE

Patent number:

JP58019488

Publication date:

1983-02-04

Inventor:

INOUE KIYOSHI

Applicant:

INQUE JAPAX RES

Classification:

- international:

C25D5/00; C25D21/12; C25D5/00; C25D21/12; (IPC1-

7): C25D5/00; C25D21/12

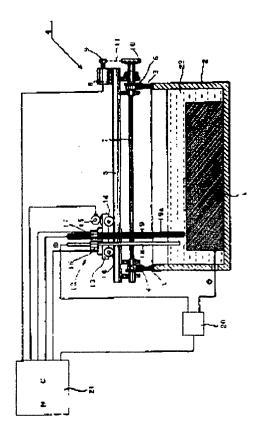
- european:

Application number: JP19810115369 19810724 Priority number(s): JP19810115369 19810724

Report a data error here

Abstract of **JP58019488**

PURPOSE: To provide a plating device by which plating layers of a uniform or desired thickness can be formed on the surface to be plated by plating the surface to be plated while measuring the thickness of the plating layer applied on said surface with a measuring electrode and controlling the position of a barlike electrode and applied electric power. CONSTITUTION: In a plating device for applying plating on an electrocast mold 1 having a complicated shape such as recessed cavities, etc. in the plating soln. 22 of a plating cell 2, a bar-like electrode 18 and a measuring electrode 19 can be moved in proximity to or contact with the desired positions on the mold 1 by the operations of a traveling carriage 4 in an X-axis direction, a traveling carriage 12 in a Y-axis direction, a vertically moving device 16 for the electrode and a vertically moving device 17 for the measuring electrode 17. The distance at which the electrode 19 is moved from a reference position until it contacts with the plating surface and the distance from the reference position up to the mold 1 are compared with a numeriacal controller 21, by which the thickness of the plating layer is calculated. The controller 21 controls the position of the electrode 18 and the applied electric power of an electric power source 20 for plating, thereby performing plating.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—19488

⑤Int. Cl.³ C 25 D 5/00 // C 25 D 21/12 識別記号

庁内整理番号 6575—4K 7141—4K **43公開** 昭和58年(1983) 2 月 4 日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

60メツキ装置

20特

願 昭56-115369

20出 顧昭56(1981)7月24日

@発 明 者 井上潔

東京都世田谷区上用賀3丁目16

番8号

⑪出 願 人 株式会社井上ジャパックス研究

所

横浜市緑区長津田町字道正5289

番地

仍代 理 人 弁理士 最上正太郎

明細 書

1. 発明の名称

メツキ装置

2. 特許請求の範囲

電型と電極間にメッキ液を供給させ、上記 電型と上記電極間に所定の通電を行ない、且つ、 必要に応じて上記電型部分に熱線を照射しつつ加 工を行なりメッキ装置において、

下配 a) 項ないし c) 項までの構成要素からなるメッキ厚さ調整装置を具備したことを特徴とするメッキ装置。

- a) 電型表面に施されたメッキ面に所定の位置 より移動し、上記メッキ面に近接又は接触してそ の移動量を測定する測定用電極。
- b) 上記測定用電極を電型表面上の所望の位置 に移動させると共に、上記測定用電極を予め定め られた基準位置から電型に向けて上記測定用電極 が上記電型に所定の近接、又は接触状態となるま で移動させる測定用電極移動装置。
 - c) 上記測定用電極の上記基準位置から電型に

近接又は接触するまでの移動距離を予めメモリーされた基準位置と電型までの距離とを比較すると とによりメッキ厚さを算出し、その算出値に基づ きメッキ加工を制御する制御回路。

3. 発明の詳細な説明

本発明は特に複雑な形状の面にも均一なメッキ を施し得るようにしたメッキ装置に関する。

凹凸に富む複雑な形状の被メッキ面に均一なメッキを施すことは電気メッキ、化学メッキ等のいずれを問わず困難である。即ち、このような面にメッキを施そうとすると、突出部、特に鋭角をなして突出する後部にはメッキ層が厚く発達するが、凹部、溝内或いはその角部や隅部等にはメッキがほとんど付かないという問題が発生する。

また、被メッキ面の一部にメッキを行なりには、 いちいち複雑、面倒なマスキング手段を講ずる必 要があり、効率的な部分メッキが行なえず、寸法 的にも限度があつた。

本発明は叙上の観点にたつてなされたものであ つて、その目的とするところは、メッキ加工時に 被メッキ面に施されるメッキ層の厚さを測定しつつ加工を行ない、被メッキ面に均一または所望の厚さのメッキ層を施し得るメッキ装置を提供しよりとするものである。

以下、図面により本発明の詳細を具体的に説明する。

第1図は、本発明にかかるメッキ装置の一実施例を示す説明図、第2図は、他の実施例を示す説明図、第2図は、他の実施例を示す説明図、第3図をよび第4図は第2図の装置に使用される電極の一部拡大断面図、第5図は第5図の装置に使用される電極の一部拡大断面図である。

第1図中1は例えば3次元形状のメッキすべき 凹状キャピテイを有する電型、2はメッキ槽、3、 3はメッキ槽2の壁体上に設けられたレール、4 は一対のIピームを平行に結合して成る車体5、 車輪6、6、車軸7、駆動用モータ8、チェーン ホイール9および10、チェーン11等から成る X軸方向走行台車、12は車体13、車輪14、 14、駆動用モータ15その他から成り、電極昇

用電極昇降装置17により昇降制御自在に支承されており、同装置17に内蔵されている図示されていないモータにより設定側定プログラム等によるシークエンス制御の昇降せしめられる。

X軸方向およびY軸方向走行台車4および12 を走行させるモータ8および15は電極18および測定用電極19を昇降させる前配モータと同様数値制御装置21により電極18及び19の電型1上に於けるメッキ及び測定位置の順次走査及び移動速度等が制御されるようになつている。

電極移動を行なり場合の理想的な様式は、電極 18の中心部が常時被メッキ面の法線と一致せし められるよう、且つ、その先端と被メッキ面との 間のギャップが常時標準値間距離に等しく保たれ るより電極18の位置および姿勢を制御すると共 に、被メッキ面の各部に対する滞留時間が均斉と なるように電極18先端を移動させると云う方式 である。(但し、とこで標準極間距離は、例えば 平面にメッキを施す際適切とされる極間距離であ る。) 降装置16 および測定用電極昇降装置17を搭載してY軸方向走行台車4の上でその要にに到した。18は必要にに関連を絶縁処理した。19点は電でするとは、19点は電でするでは、19点は電でするでは、19点は電では、19点は電では、19点は電では、19点は電では、19点は電では、19点は電では、19点は電では、19点は電では、19点は電では、19の過程をでは、1分のでは、1

而して、電極18は電極昇降装置16により昇降自在に支承されており、同装置16に内蔵されていないモータにより電型1のメッキキャピテイ形状に応じ、例えば電極18の先端と電型1との対向間隙が常に所定の、好ましくは小さい所定間隙に維持されるように昇降制御せしめられる。また、測定用電極19も同様に測定

この極間距離が大きいと巨視的にはメッキは均一に施されるが、電力損失が増大する上、被メッキ面の起伏、凹凸によつてメッキ層の厚みに不均一が生ずるという問題がある。

これに反し、極間距離をあまり小さくすると、 電極パスの全長が長くなり、数値制御プログラム も冗長となるばかりでなく、電極パスに沿つたり ねりが生じるので、自ら適切な極間距離が定めら れるものである。

然しながら、このような制御を行なりためには 複雑で高価な電極制御装置を必要とするばかりで なく、数値制御プログラムの作成にも繁雑な計算 を必要とするので、この方法は実用的とはいえな い。

而して、本装置においては、電型1表面のメッキが施された部分に測定用電板19が所定の位置より接触するまで測定用電板昇降装置17が駆動し、その移動距離が測定される。との測定値は数値制御装置21において基準値となる電型1表面にメッキが施される以前の同位置までの測定用電

他19の移動距離と比較され、この比較値に応じてあらかじめ定められたプログラムに従つてX軸方向およびY軸方向走行台車4および12を走行させるモータ8および15、並びに駆極18および制定用電極19を昇降させるモータと、電型1と電極18間に所定の極性の直流電圧若しくはパルス電圧を供給する電源回路20を制御するので、電型1の形状等を問わずその表面には略均一な厚さのメッキ加工が施されるのである。

測定用電極19の周鑒部は合成樹脂等の絶縁性 部材19aで發われていて、測定用電極19が腐 蝕するようなことがないようになつている。

次に第2図、第3図および第4図について説明する。第2図はメッキ加工時に加工部分に熱線を照射しつつ加工を行なり装置の実施例を示しており、電極および制定用電極の駆動方法、電圧供給方法等は第1図に示したものと同様であつて、第3図で第1図と同一な番号を付したものは同一な構成要素を示し、図中18aは導電性のパイプ状の電極、23aはパイプ状電極18aの先端に取

れている凸レンズ23 a で焦点が絞られ、電型1のメッキが施される部分に照射される。また、本実施例装置は第1図の実施例装置の如く、電極と対向した電型のある一定の範囲にメッキ加工が施されるものと異なり、熱線源24からの光線が照射された部分のみメッキが施されるので、 脚定用電値19の移動方向は常に定まつている。 即ち、熱線源24からの照射が行なわれメッキ加工が施されたあとを測定用電値19が追随して測定して行くように構成されている。

而して、この実施例装置により加工が行なわれる場合には、室温またはこれ以下の温度にメッキ液22を保つておくと共に、電源回路20の電圧も従来慣用の条件における電圧前後以下に設定して、メッキが極めて遅い速度か、または殆んどメッキが進行しないようにしておく。また、この時、電型1のメッキを施す部分には熱線源24からの光線がパイプ状の電極18aの内部を通過して凸レンズ23aで無点が絞られてその部分に照射されるので、その電型1の表面または表面近くのメ

り付けられた透明者しくは半透明の凸レンズ、2 3 b は素通しのガラス、2 4 は熱線原、2 5 は熱 線原2 4 の下端に固定して設けられ、パイプ状の 電極18 a を支承する電極ホルダである。

而して、導電性の材質で製作されたパイプ状の 電極18aの先端部分には透明若しくは半透明な 凸レンズ23aが取り付けられ、そして、パイプ 状の電極18aは熱線源24の下端に固定された 電極ホルダ25に取り付けられている。

ッキ液 2 2 温度は約45~60℃のメッキに最適 な温度に加熱され、従つて、当該部分が活性化さ れて析出効率が向上し、当該光線照射部分のみに ほぼ選択的にメッキが施される。また、凸レンズ 2 3 a を適宜調節してビームスポットの大きさに 応じた領域に限定してメッキを施すことも可能で ある。

パイプ状の電極18aの先端部分に取り付けられる透明若しくは半透明の凸レンズ23aは、照射部分の形状があまり複雑でなくピームスポットの調節等を必要としない場合には紫通しのガラス23b等に変更できるものである。

また、上記レンズ23 a 等の光学素子は 、パイプ状電極18 a、18 b 内へのメッキ液の侵入を先端の透光ガラスや管内供給圧給気体によつて防止するとか、メッキ液22の液位が浅く、電極先端の液中挿入長さが短い場合には、上配光学素子を電極軸方向の適宜の位置に設けて熱級の集中、拡散、或いはビームスポットの大きさ等を設定制御するように構成することができ、またパイプ状

電極内の一部または全部を1本以上の光学フナイバグラスの挿般により導光路とするように構成しても良い。

而して、パイプ状の電極18bは電極ホルダ25 に取り付けられていて、無線源24からの光線はパイプ状の電極18b中を通過して電型1のメッキが施される部分に無射される。然しながら、第

また、パイプ状の電極としては導電性のパイプ 状の電極18bに限定されず、第6図に示した如 き合成樹脂等の不溶性パイプ18cの先端周騰部 分に金属性電極部材29を取り付けて電極とした ものをも使用できるものである。

本発明は叙上の如く構成されるので、本発明装置によるときは、電型表面に施されたメッキ層の厚さを逐次測定しつつ加工を行なりので、複雑な形状の電型にも均一な厚さのメッキ層を形成するととが可能となるのである。

なお、本発明の構成は叙上の実施例に別にないて るものではない。即ち、例えば、本実施のに限しておき電極を三軸方向に移動させて てかきメッキ槽全体をクロスクスライドを ではからのためでは型にメッキ層を配面でしてもよい。まかには、パイプ状の電極のでは など、カルファイバを多数結束してなるものに オプチカルファイバを多数結束してなるものに オプチカルファイバを多数結束してなるものと オプチカルファイバを多数によりに オプチカルファイバを多数に オプチカルファイバを オーカート

5 図に示した実施例装置においては、パイプ状の 電値18bの先端部分が開放されているのでパイ プ状の電極18b内にメッキ液22が浸入すると とがないよりな構造となつている。即ち、パイプ 状の電極18bの側壁にはパイプ状の電極18b 中にコンプレッサー28からの圧縮空気を送り込 むための小穴が設けられている。而して、御定用 電極19が所定の位置より移動して、電型1表面 のメツキが施された部分に接触しその移動距離を 測定すると、この測定値が数値制御装置21にお いて基準値となる単型1表面のメツキが施される 以前の同位置までの制定用電極19の移動距離と 比較され、との比較値に応じてあらかじめ定めら れたプログラムに従つてパイプ状の電極18bの 先端部分の液圧よりやや高い圧縮空気になるよう に関圧弁27を制御してパイプ状の電極18b内 に圧縮空気を送り込む。従つて、パイプ状の電極 18b内にはメツキ液22が侵入することがない ので、光線源24からの光線を観型1に直接投光 せしめることが可能となる。

自由に設計変更できるものであり、本発明はそれらの全てを包接するものである。例えば、測定用 電極の昇降によるメッキ厚さの測定には、電極1 9の先端が、之に対向する電型1のメッキ面に直接吸触したのを電気的手段等によつて検出するものの外に、上配先端に所定の比較的小さな近接間酸となつたとき之をその間隙の抵抗、静電容量、電圧、電流、又は光や超音波の送受波等によつて検出するととにより電極の下降を停止させるとか、所定のブログラム等された予定量の下降をさせてその際に形成される間談を先端に設けた検出器によつて測定する等の変更実施が可能なものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明にかかるメッキ装置の一実施例を示す説明図、第2図は、他の実施例を示す説明図、第3図および第4図は第2図の装置に使用される電極の一部拡大断面図、第5図は更に他の実施例を示す説明図、第6図は第5図の装置に使用される電極の一部拡大断面図である。

2 ………メッキ相 3 ……… レール 5、13……車 体

7 …… 車 軸

8、15……駅動用パルスモータ

1 2 ·············Y 軸方向走行台車

18 …… - 棒状電極

18a、18b …… 導電性のパイプ状の電極

19………测定用電框

20 ………電源回路

21 ………数值制御回路

22…………メツキ液

2 3 a ………凸レンズ

23b………集通しのガラス

2 4 ………熱熱源

25………電框ホルダ

26 …… 校 り

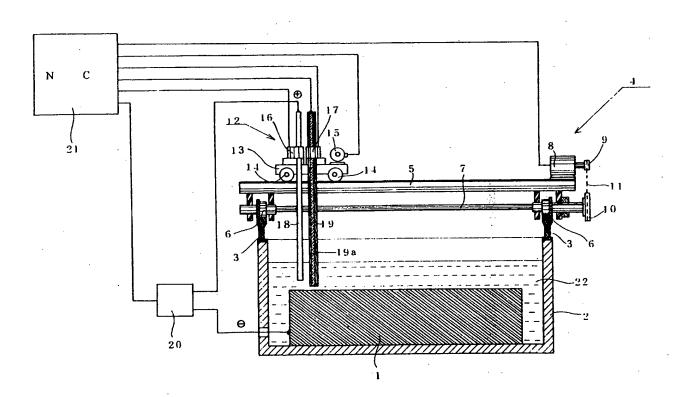
2 7 …………調圧弁

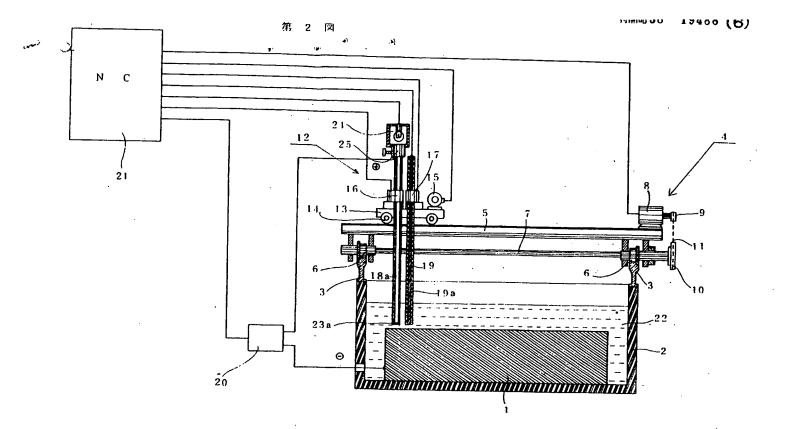
株式会社 井上ジャパツクス研究所

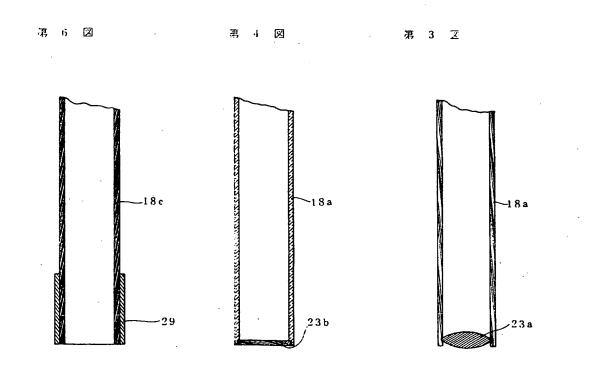
(7524) 最 上 正太郎 代 理 人

28………コンプレッサー 29 ………金属性電極部材

第 1 図







第 5 図

